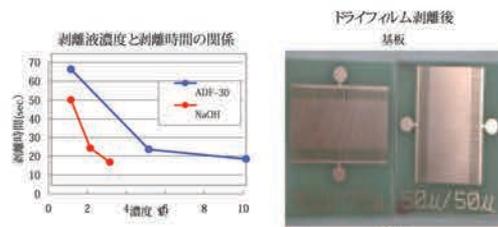
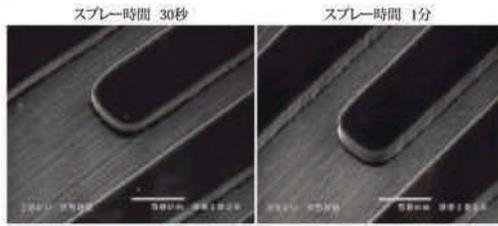


新商品評価 - 薬品

事例1 薬液評価試験



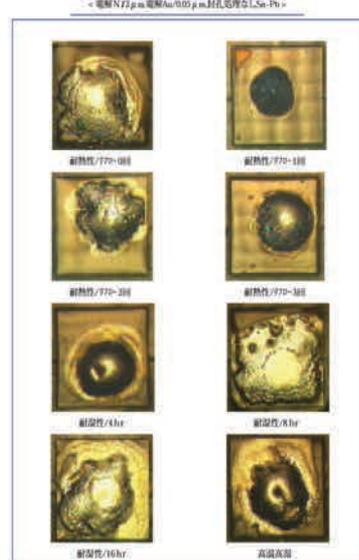
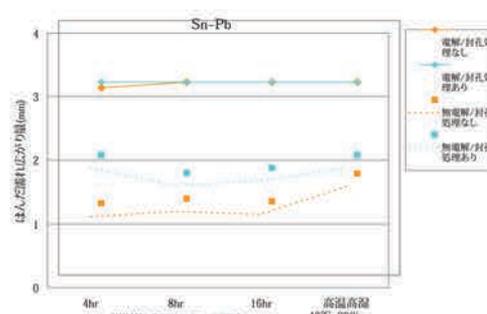
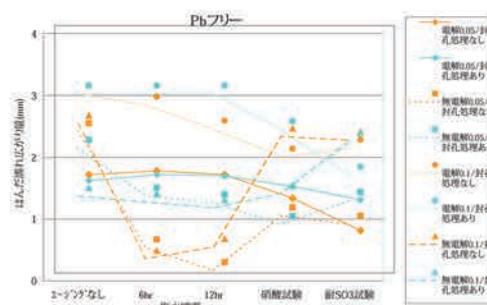
剥離液濃度と剥離時間の関係

濃度 (%)	AUF-30 剥離時間 (sec)	NaOH 剥離時間 (sec)
0	~65	~50
2	~45	~25
10	~20	~15

考察
標準濃度での剥離時間はそれほどかわりなく、大きな濃度変化がない限り剥離時間に影響はない。しかしAUF-30で剥離した場合、パターンの銅表面にNaOHで剥離したときのようなアルカリ焼けが見られなく、ドライフィルムがそのまま残るため過しやすい。

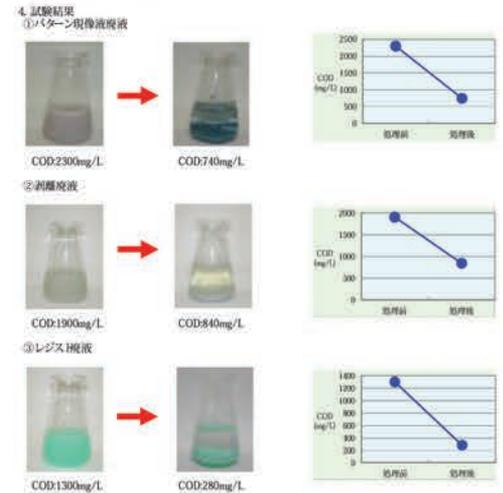
事例3 封孔処理剤評価試験

1. 実験目的
TAF-410封孔処理剤の効果を確認する。
2. 実験条件
基板: 無電解Ni-Auめっき基板 Auめっき厚 0.05, 0.1, 0.3 μm Niめっき厚 3 μm
電解Ni-Auめっき基板 Auめっき厚 0.05, 0.1, 0.3 μm Niめっき厚 3 μm
封孔処理: なし、あり
はんだボール: φ0.05 Sn-37Pb
エージング: 耐熱性: リフロー回数 0, 1, 2, 3
耐湿性: PCT105°C-100% 4, 8, 16時間
高温高湿: 40°C, 90% RH 168時間
3. 評価試験
はんだ濡れ性試験 (リフローによるはんだボールの濡れ広がりを確認する)
上記のエージング処理したものをパッドにフラックス (LF-550V-6 タムラ研) を塗布する。
中央にはんだボールを置き、リフロー試験機にセットする。



事例2 薬液評価試験

1. 評価薬品
R-4000
2. 試験方法
現像液 (4% NaOH, 25% NaO₂S₂O₈, 阻像液 (炭酸ナトリウム使用) を通常 (マニュアル) の方法で処理試験を行い、処理能力の確認を阻像液のCOD濃度測定により行った。
3. 試験条件
サンプル (廢液) 採取
↓
R-4000を濃液1000mlにたいして3ml加える。
かき混ぜながらゆっくり硫酸 (60%) を加える。(pH2.8になるまで)
静置後濾過し、ろ液のCOD値を分析する。



5. 考察
マニュアル通りの使用量では、完全には、処理が出来ず追加して添加する必要があったが、少量 (廢液に対して約0.1%) の添加で、COD値を半減以下まで減少させることが可能であり、効果的な試薬であると考えられる。